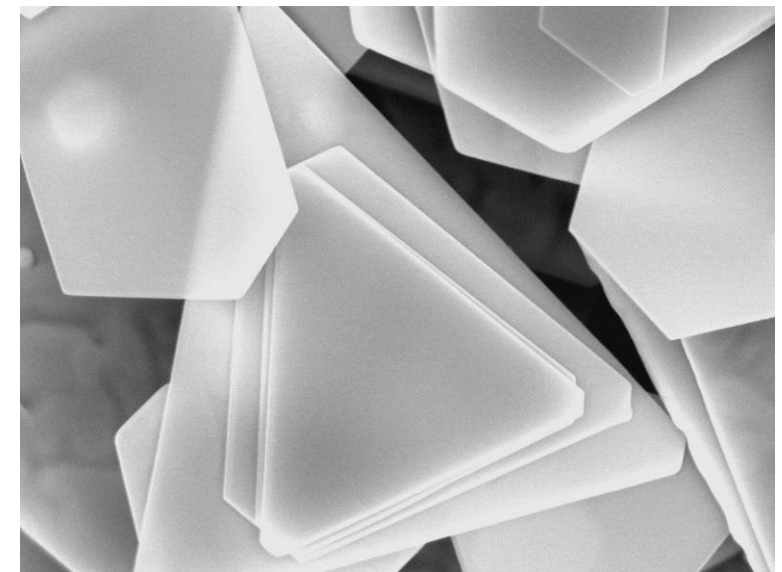


特线专有形状的超微细银粉

特征

- 因本公司的银粉是单晶结构，具有高导电性和热传导性。
- 通过低温烧结，使材料具有高导电性和粘合强度。
- 因表面平滑性非常高，可实现反射效率高且润滑性高。
- 因薄型和微细级大小等的特性，特别适应于精密级印刷。



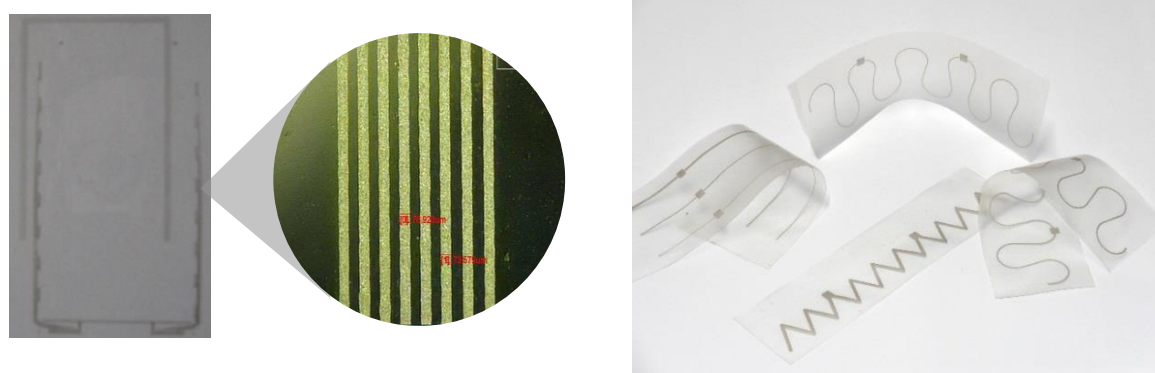
用途例子1

<电子材料·半导体范围>

导电性电路材料 (用于电子材料的接线)

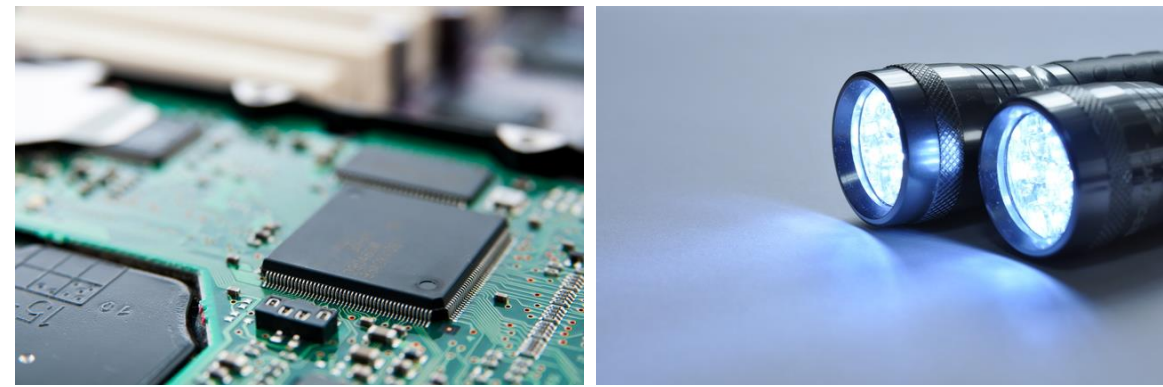


作为电子器械的导电配线，对于器械的高性能化及小型化有不可或缺的作用。

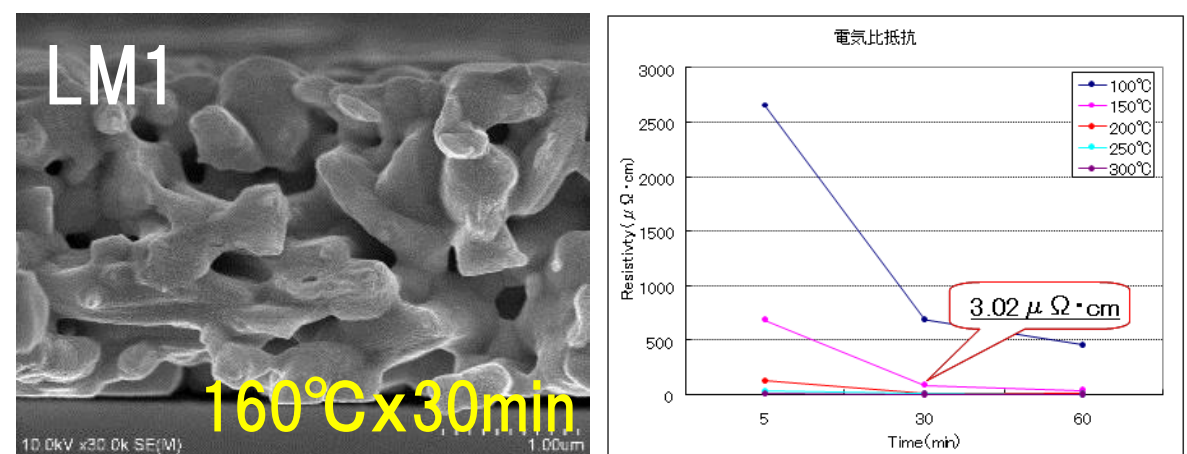


银粉的精细特性可对应高度精确的图案打印，其光滑的形状特征，可灵活的对应各种图案打印要求。

导电性粘合剂材料 (电子部件的接合，散热用)



主要用于高要求的电子材料的粘合剂，具有导电和散热作用。

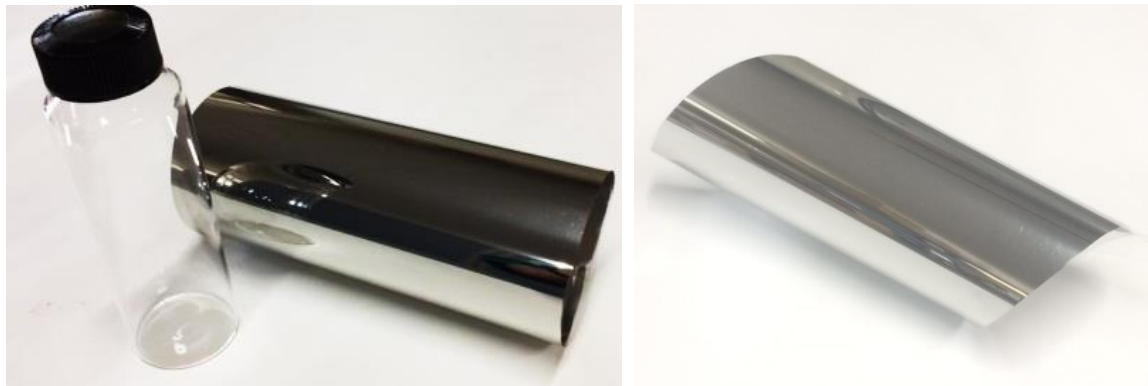


由于低温烧结，实现高导电性和高附着性。

用途例子 2

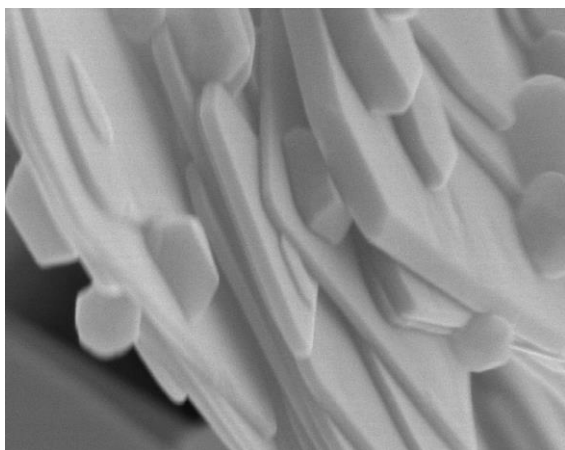
<涂料・功能性材料范围>

金属漆，镜面漆



因光滑的尺寸特性，可以很好的发挥银的原始光泽和镜面。

润滑性，功能性涂料



因光滑的尺寸特性，可以期待高润滑性。

应用于其他用途

期望利用平滑和薄的形状特征，将其应用于各种用途。

其他特征



按照您希望的状态提供。
有机溶剂(溶剂可选)，水融，粉末状态。

通过有机涂覆银表面可以控制亲水性和疏水性。

品质特性

产品名称	N300	M13	M27	LM1
D10(μm)	-	0.5 ≤	1.0 ≤	-
D50(μm)	0.4 ± 0.1	2.0 ± 0.5	4.5 ± 1.0	1.0 ± 0.3
D90(μm)	-	4.8 ≥	10.0 ≥	3.6 ≥
烧结温度(°C)	180°C x 30分	200°C x 30分	200°C x 30分	160°C x 30分
阻力值(μΩ · cm)	4.0	3.6	4.2	4.9

